

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 2 区分

【発行日】平成20年7月10日(2008.7.10)

【公表番号】特表2008-504963(P2008-504963A)

【公表日】平成20年2月21日(2008.2.21)

【年通号数】公開・登録公報2008-007

【出願番号】特願2007-519215(P2007-519215)

【国際特許分類】

B 2 3 K 35/363 (2006.01)

H 0 5 K 3/34 (2006.01)

B 2 3 K 35/22 (2006.01)

B 2 3 K 1/00 (2006.01)

B 2 3 K 35/26 (2006.01)

C 2 2 C 13/00 (2006.01)

B 2 3 K 101/42 (2006.01)

【F I】

B 2 3 K 35/363 C

H 0 5 K 3/34 5 1 2 C

B 2 3 K 35/363 E

B 2 3 K 35/22 3 1 0 B

H 0 5 K 3/34 5 0 5 B

H 0 5 K 3/34 5 1 2 B

B 2 3 K 1/00 A

B 2 3 K 1/00 3 3 0 E

B 2 3 K 35/26 3 1 0 A

C 2 2 C 13/00

B 2 3 K 101:42

【手続補正書】

【提出日】平成20年5月19日(2008.5.19)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

キャリアに端子を結合するためのはんだ系であって、
鉛（Pb）の存在を検出するための鉛（Pb）インジケータと、
前記鉛（Pb）インジケータ用のキャリアとして機能するはんだフラックスと、を備えるはんだ系。

【請求項 2】

前記はんだ系が、前記キャリア上にコーティングを含む請求項 1 に記載のはんだ系。

【請求項 3】

前記キャリアが、プリント回路基板及びボール・グリッドアレイ基板からなるグループから選択されることを特徴とする請求項 2 に記載のはんだ系。

【請求項 4】

半導体デバイスを形成する方法であって、
キャリアを準備する段階と、

前記キャリアに、鉛（Pb）インジケータとはんだフラックスとを含むはんだ系を施工させる段階と、

前記はんだ系を介して前記キャリアに端子を結合する段階と、

前記はんだ系を溶融して前記キャリアに前記端子を取り付け、完成半導体デバイスを形成する段階と、

前記完成半導体デバイスが前記はんだ系とは異なる予め定められた特性を有するかどうかを判定する段階と、

を含む方法。

【請求項5】

前記判定段階が、前記完成半導体デバイスを外観検査する段階を更に含む請求項4に記載の方法。